

证券代码：002129

证券简称：中环股份

## 天津中环半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2018-1-9

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	东吴证券：曹 越、汪林森 泓德基金：章 健、殷子涵 露鸣投资：李华飞、刘智澍、张秀峰 中泰证券：朱荣华、于文博 中再资产：籍扬宇、程 军 中信建投：周紫光 工银瑞信：闫思倩 万联证券：蔡梓林 国寿安保：姜绍政 信诚基金：孙浩中 泰康资管：段中喆 中海基金：马 冲 华安基金：苏广宁 汇添富基金：刘昇 华创证券：杨达伟 朱雀投资：李 洋
<b>时间</b>	2018年1月9日
<b>地点</b>	天津中环半导体股份有限公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总经理、董事会秘书：秦世龙 证券部副部长：蒋缘

**投资者关系活动  
主要内容介绍**

一、简要介绍公司基本情况

二、互动交流

交流问题如下：

1、公司光伏产业的扩产进度安排以及产能释放预期是什么？

公司以内蒙古地区作为主要的太阳能级单晶生长和制造基地，发挥单晶硅技术优势、规模领先优势，不断扩充太阳能级单晶硅材料产能，在全球光伏市场实现规模和技术全面领先，已布局并实施了中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三期项目，目前正在投资建设四期及四期改造项目，项目建设完成后，公司太阳能级单晶硅材料年产能将提升至 23GW 左右。目前四期及四期改造项目正在按照计划有序推进，产能将随着项目建设和设备调试进度的推进逐步提升。

2、公司集成电路大硅片项目的技术储备和最新建设情况是怎样的？

公司在半导体行业具有六十年的历史积淀，对于半导体材料技术的发展具有深刻的理解，并且具有深厚的技术积累和经验积累。公司实施的“集成电路用大硅片生产与制造项目”既是公司现有半导体材料产能规模的扩张，也是公司多年来在半导体行业技术与经验积累的再一次全面提升。

根据公司战略发展规划，为发挥各方优势、整合各方资源，公司与合作方无锡产业发展集团、晶盛机电共同合资组建了中环领先半导体材料有限公司，作为项目实施主体建设集成电路用大硅片生产与制造项目，发展半导体材料产业。项目总投资约 30 亿美元，一期投资约 15 亿美元，将打造国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地。

3、公司在设备采购方面，是否将晶盛机电作为公司重点设备供应商？

公司和晶盛机电具有良好的合作历史积累和紧密的合作伙伴关系。公司 2011 年承担的国家重大科技专项“02 专项”，打破了国外

对大直径 8 英寸区熔硅单晶、设备市场的封锁和制造大直径 IGBT 器件用主要材料的垄断局面，晶盛机电是主要设备供应商之一。同时目前实施集成电路用大硅片生产与制造项目的中环领先，晶盛机电也作为合作方之一参股其中，这是公司与晶盛机电再一次在半导体领域的深度合作，有利于提升半导体材料关键设备、工艺、软件的国产化程度，实现半导体材料技术的重大突破，促进公司及晶盛机电综合竞争力提升，实现互利共赢。

采购业务管理方面，公司是依据市场化原则采购项目所需的设备及生产所需原辅材料，各项目的设备采购也会严格执行招标程序最终确定中标供应商。

#### 4、公司在新能源产业降成本的路径和方法是什么？

公司始终秉承“少人化、自动化、高效化、智能化”的制造理念，实施科学管控，聚焦核心业务、科学内部管理体系、改进运营模式，同时建立了公司自己的研发平台，核心部件自主配套体系，培养了一大批优秀的科技人员、工程技术人员以及信息化管理人才，结合制造业“工业 4.0”的先进理念，在 ERP、MRP II、工厂物流现代化、工业自动化控制等各方面都达到了国际先进、国内领先水平。通过实施集约创新、集成创新、联合创新等创新方式，加快新技术的应用、降低生产成本、提高生产效率。公司近年来一系列的重大创新成果使公司保持行业技术引领者地位，例如公司在直拉单晶生长技术和金刚石线切片技术等方面取得的重大技术进步使得公司的单晶硅材料生产效率得到了进一步提升。

#### 5、光伏硅片市场价格下降是否会影响公司毛利率？

光伏行业近年来产业链各环节技术革新和成本下降速度加快，行业内预计 2020 年左右实现光伏发电平价上网是基于技术进步和成本下降的理性判断，因此光伏硅片的价格在中长期趋势中也将逐步下降。公司通过技术进步和生产效率的提高降低生产成本，始终实施围绕晶体生长技术为核心的相关多元产品的技术开发和生产制

	<p>造，因此公司有能力也有信心在行业发展和市场变化过程中实现公司的稳健经营和长期可持续发展。</p> <p>6、公司 8 英寸半导体硅片项目现有产能和扩产计划是什么？</p> <p>通过公司承担的国家重大科技专项“02 专项”项目，公司已建成 IGBT 用区熔硅单晶产业化示范基地，形成了每月 5 万片 8 英寸 IGBT 用抛光片的生产能力；同时公司通过“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”扩建 8 英寸抛光片生产线，该项目达产后，将形成年产 293 万片 8 英寸抛光片的产能，目前项目正在按计划实施建设中。</p> <p>7、公司叠瓦组件技术的领先程度和生产情况是怎样的？</p> <p>公司联合国内外知名企业和技术合作方 SunPower、东方电气集团，共同实施叠瓦太阳能组件项目，在普通组件加工工艺基础上，运用独特的叠瓦技术，使得单位面积下可以叠放多于常规组件的电池片，组件转换效率相比常规组件提升 7% 以上。同时通过组件结构的优化，保证了组件封装过程中的最小功率损失，降低了反向电流对于组件产生热斑效应的影响，提高了组件对的稳定性。项目达产后，将形成年产 5GW 的组件生产能力。2017 年 7 月，该项目第一块叠瓦组件顺利下线，到 2017 年末已经形成了叠瓦组件批量产出和销售的能力，同时也具备了持续向国内外用户提供高效叠瓦组件产品的能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018 年 1 月 9 日